

# 上海硅产业集团股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

股票名称：沪硅产业

股票代码：688126

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位/个人	国信、中金、国泰海通、长江、华泰等机构和个人投资者通过电话和网络参加会议。
时间	2025年9月1日
地点	线上交流
公司接待人员	邱慈云、李炜、黄燕、方娜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、半导体行业和沪硅产业经营情况介绍</p> <p>今年上半年，全球半导体市场、包括半导体硅片市场整体都有所改善，但复苏速度慢于预期。在这样的大环境下，沪硅产业面临着诸多挑战。从业绩数据来看，我们上半年实现营业收入 16.97 亿元，同比增长 8.16%。其中第二季度单季营收 8.96 亿元，环比第一季度增长 11.75%。然而，我们归属于上市公司股东的净利润仍然为负，这主要是由于硅片市场的复苏滞后于终端市场、芯片制造等产业链的下游环节，硅片产品价格在全球范围内仍面临较大压力，再加上我们持续扩产带来的折旧摊销费用、持续较高水平的研发投入及其他固定成本增加的影响，导致短期内仍然处于亏损状态。</p> <p>在业务方面，我们的 300mm 硅片业务取得了显著进展。公司的产能利用率处于较高水平，出货量同比有所增加。上半年，我们上海、太原两地 300mm 硅片合</p>

计产能已达到 75 万片/月，规模位居国内第一梯队。

我们在技术研发和新产品成果上亮点颇多。上半年，我们开发了 50 余款 300mm 硅片新产品。截至 2025 年 6 月末，公司 300mm 硅片业务的累计客户数量超过 100 家，产品广泛用于逻辑芯片、存储、CIS 等应用。我们的 300mm 硅片产品凭借高纯度、低缺陷、良好的表面质量和性能参数，以及稳定的供应，受到了相关客户的高度认可。

在 300mm SOI 业务上，作为国内唯一具备 300mm 硅片衬底和 300mm SOI 产品技术全自主知识产权和技术能力的企业，我们在国内的领先性更是凸显。公司 300mm SOI 业务在过去半年里取得了阶段性突破，已开始向多客户批量送样。特别是面向高压高可靠性高算力应用的 300mm SOI 硅片已正式开始流片，目前已完成客户送样并通过客户内部的特殊工艺验证。目前，我们的 300mm SOI 产品能够满足各类应用领域对衬底材料的严格要求，并已与多家行业内领先的设计及制造企业建立了合作关系，具备为其提供高质量的 300mm SOI 硅片的能力。

然而，200mm 及以下的硅片市场还未完全复苏，公司 200mm 及以下尺寸硅片业务表现仍较为疲软。不过，我们的子公司在各自领域都在积极探索。芬兰 Okmetic 持续推进其产品 MEMS、传感器、射频滤波器和功率器件领域的应用；新傲科技在 200mm SOI 和 200mm 及以下外延业务方面持续推动转型升级，着眼产品高性能应用，以期在 IGBT/FRD 等产品应用市场争取获得更广泛的渗透。

从行业发展趋势来看，虽然当前面临挑战，但我们对未来充满信心。随着终端市场需求的持续增长，下游

客户库存水平逐步正常化，半导体硅片出货量及价格的持续回暖值得期待。特别是各类新兴市场的崛起，将为半导体硅片行业带来新的增长动力。展望未来，我们将继续坚持技术研发、新产品开发和市场开拓。在技术研发上，不断突破创新，尤其是在 300mm 硅片业务和 300mm SOI 业务上，持续提升产品的技术含量和附加值，以满足新兴市场对高性能硅片的严苛需求；在新产品开发上，紧密围绕市场需求，扩充产品种类；在市场开拓上，进一步扩大国内外市场份额。

## 2、投资者交流

问 1：当前半导体硅片价量的情况。

答：从量的方面，300mm 硅片需求持续增长，尤其在存储领域增速明显；200mm 硅片已触底，但复苏较为缓慢。从价格方面，仍然承压，主要来自新进竞争者、客户降本要求及市场竞争加剧。

问 2：2025 年、2026 年的折旧预期

答：2024 年折旧约 9 亿元，2025、2026 年仍处于资本开支高峰期，后续随设备完全折旧后，增速会逐步下降。

问 3：当前 200mm 和 300mm 硅片的产能利用率

答：300mm 产能利用率较高，200mm 回升仍然略显乏力，个别品种开工率较高。

问 4：硅片产品的国产化率

答：300mm 硅片在存储领域国产化率高于逻辑芯片，200mm 硅片除特殊产品外已基本实现国产化。

	<p>问 5: 公司 300mm 产品产能规划及海外市场规划</p> <p>答: 目前产能已达到 75 万片/月, 已公布的产能规划将达到 120 万片/月。海外市场拓展方面, 公司已与较多海外客户建立合作, 未来将借助海外子公司渠道进一步提升国际销售占比。</p> <p>问 6: 300mm 硅片未来价格提升空间及下游领域复苏情况</p> <p>答: 随着正片占比提升、LTA 订单结束及整体市场需求增长, 价格有望企稳回升。300mm 硅片需求整体向好, 下游市场中, 存储、逻辑和功率器件等领域预计率先复苏, 消费电子和手机市场需等待 AI 应用驱动增长。</p> <p>问 7: 掺砷产品进展</p> <p>答: 掺砷产品在太原基地研发生产, 目前已向客户送样, 正处于认证阶段, 预计未来几个月将取得进展。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2025 年 9 月 1 日